

/ Descriptions

MM E 3 3 0 Z 1

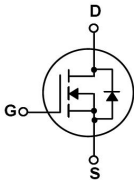
/ Features

H 3 U/H r i 3 k/Ä H 3 y 0

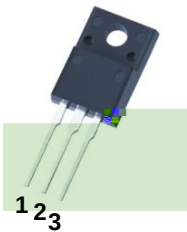
/ Applications

Ä 3 3 3 I ' GF2GF 3 "Ö 3 I ' Ä H

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



X X X

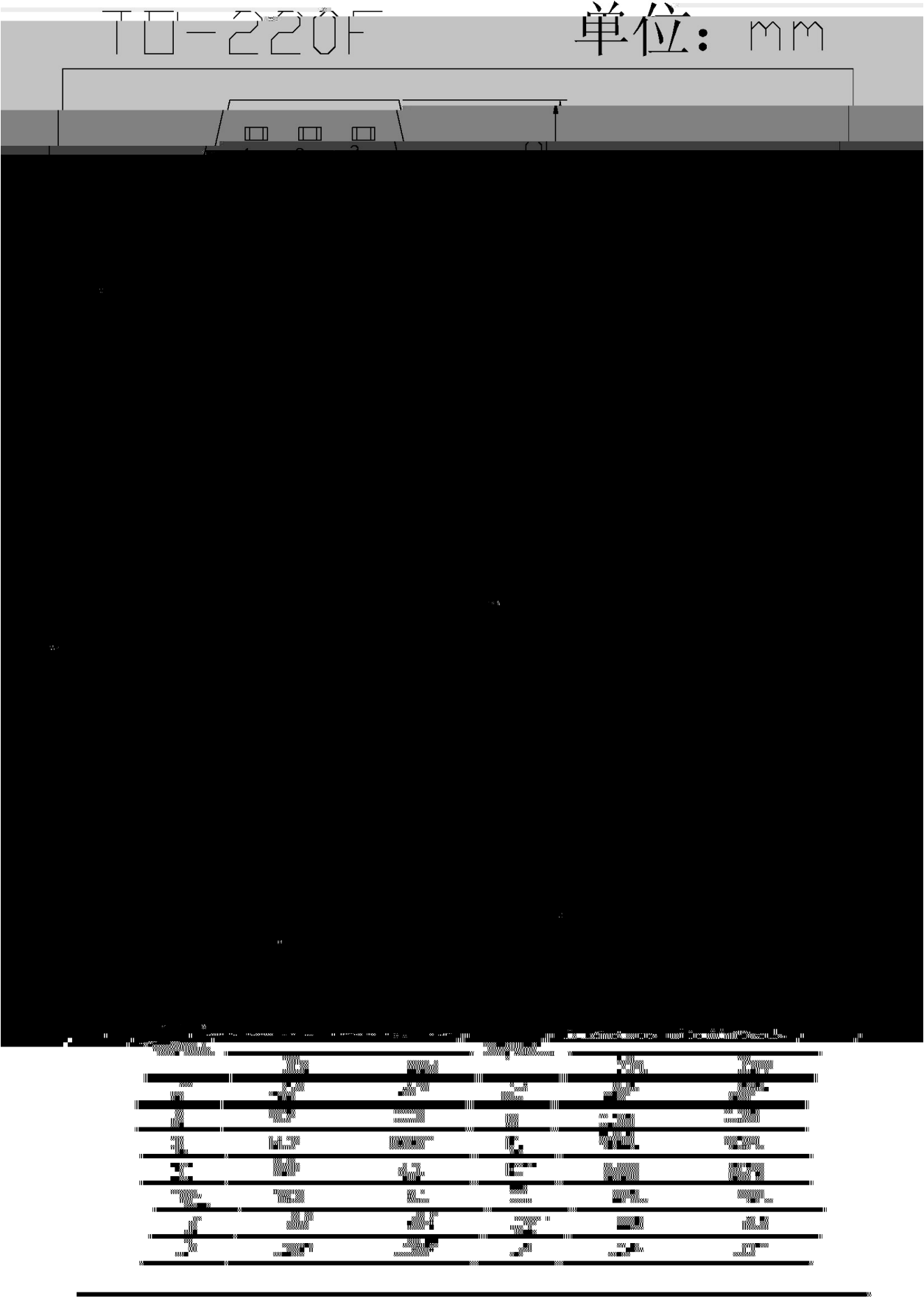
/ hFE Classifications & Marking

0 M 1 3 "

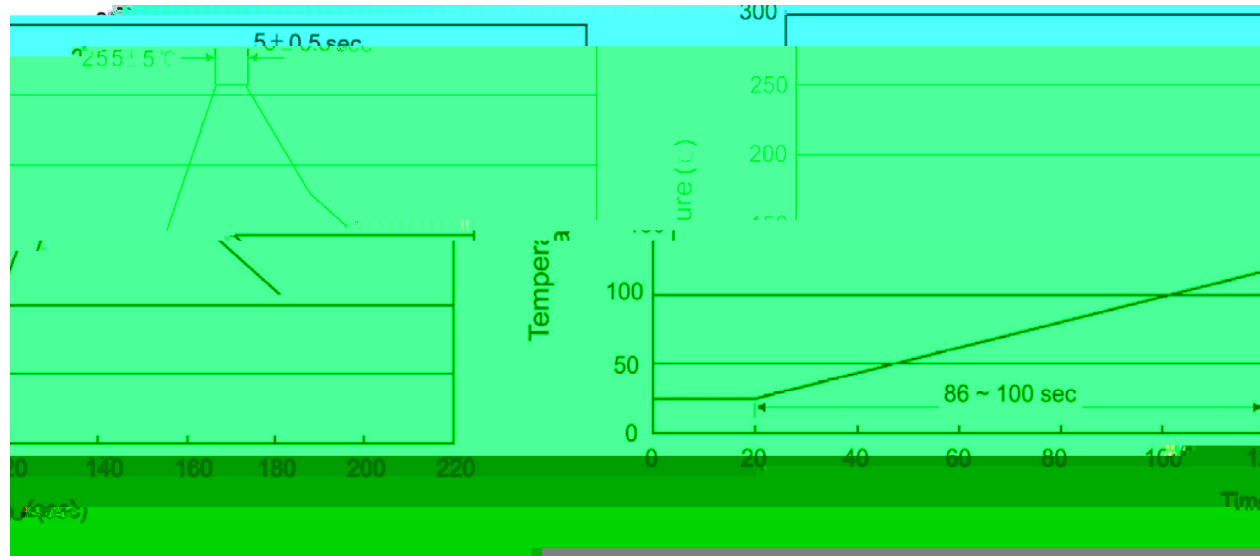
Ƶ "Œ	Ÿ N	"Œ Œ	D Œ
------	-----	------	-----

/ Electrical Characteristic Curve

/ Package Dimensions



() / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



1. 焊接温度：235±5℃，时间：5±0.5s。
2. 冷却时间：86~100s。
3. 焊接后，元件表面温度应降至86℃以下。

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

1. 焊接后，元件应能承受规定的焊接热应力。

/ Packaging SPEC.

1. 包装形式：

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只袋	袋盒	只盒	盒箱	只箱	袋	盒	箱

2. 包装尺寸：

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只套管	套管盒	只盒	盒箱	只箱	套管	盒	箱

/ Notices